芯联集成电路制造股份有限公司
2024 第一季度报告

证券代码:688469　证券简称:芯联集成

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,352,995,972.16		17.19
归属于上市公司股东的净利润	-242,117,693.08		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-298,588,082.98		不适用
经营活动产生的现金流量净额	306,117,266.28		40.68
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	481,619,248.91		111.97
基本每股收益(元/股)	-0.03		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.96		不适用
研发投入合计	470,149,903.00		36.32
研发投入占营业收入的比例(%)	34.75		增加4.88个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	34,947,660,076.07	31,570,366,445.66	10.70
归属于上市公司股东的所有者权益	12,250,909,940.13	12,483,074,709.70	-1.86

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,679,416.04	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	55,447,168.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,217,615.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,367,061.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	1,882,039.55	
合计	56,470,389.90	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	40.68	主要系(1)随着公司业务规模的扩大,公司及产品在市场上的竞争地位、影响力、信用等进一步增强,与上下游合作伙伴建立了长期的战略合作关系,获得其供应保证和高优先级服务,以及高质量和极具成本竞争力的方案;(2)收到政府补贴款。
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	111.97	主要系(1)受市场需求复苏的影响,公司收入规模扩大,较上年同期增长17.19%;(2)公司通过成本控制和成本改善项目的推行,强化与核心战略合作伙伴的合作和协同降本提效等措施,现金毛利向好;(3)因公司符合高质量发展的集成电路企业要求,享受了财政部及税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减的优惠政策,报告期内产生的其他收益较上年增加。
研发投入	36.32	主要系市场需求复苏,为了保障公司在未来市场旺盛需求阶段中能获得和巩固更多中高端技术及产品的市场份额,公司继续在12 英寸车规级BCD平台、SiC MOSFET、功率模组等方面保持足够的研发投入强度。 (1)车载领域 高压BCD、嵌入式数模混合控制BCD等平台发布;全新一代车载IGBT芯片和多款SiC模块以及混碳模块样品已在客户端验证通过, 开始大规模客户导入和量产起量。 (2)风光储充等工控领域 结合终端多款新机型应用需求,公司研发并导入了多款产品,如大功率光伏逆变产品,大功率储能PCS产品和面向高压大功率风电的高功率产品,为全球风光储充头部企业提供高功率、高可靠性、高稳定性的功率半导体IGBT、SiC芯片及模块。 (3)家电应用领域 研发出全系列智能功率模块产品,产品应用覆盖绿色和智能家电,已开始批量生产。 这些研发成果带动公司在报告期内导入新客户50多家,客户覆盖汽车领域的国内外主机厂和Tier 1,以及风光储、家电领域等行业头部,为未来收入的快速增长奠定了基础。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	188,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,152,000,000	16.35	1,152,000,000	1,152,000,000	无	
中芯国际控股有限公司	境内非国有法人	993,600,000	14.10	993,600,000	993,600,000	无	
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	230,400,000	3.27	230,400,000	230,400,000	无	
绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	216,000,000	3.07	216,000,000	216,000,000	质押	160,000,000
宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	181,440,000	2.58	181,440,000	181,440,000	无	
共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	153,000,000	2.17	153,000,000	153,000,000	无	
共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	153,000,000	2.17	153,000,000	153,000,000	无	
MASTERWELL (HK) LIMITED	境内非国有法人	144,000,000	2.04	144,000,000	144,000,000	无	
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	139,680,000	1.98	139,680,000	139,680,000	无	
共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	126,000,000	1.79	126,000,000	126,000,000	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张跃军	15,101,593	人民币普通股	15,101,593
高盛公司有限责任公司	10,890,242	人民币普通股	10,890,242
UBS AG	8,707,054	人民币普通股	8,707,054
尚融资本管理有限公司	6,853,710	人民币普通股	6,853,710
赵智信	4,221,960	人民币普通股	4,221,960
应欢如	4,120,592	人民币普通股	4,120,592
王乐康	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
韩景华	3,186,500	人民币普通股	3,186,500
危超明	2,880,784	人民币普通股	2,880,784
领航投资澳洲有限公司	2,616,718	人民币普通股	2,616,718
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.越城基金与青岛聚源芯越二期存在关联关系; 2.中芯控股与青岛聚源芯越二期存在关联关系; 3.硅芯锐、日芯锐存在关联关系; 4.共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯存在关联关系; 除了上述股东关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(1)公司回购事项进展情况:

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司2024年3月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《芯联集成电路制造股份有限公司关于公司董事长提议公司回购股份的公告》(公告编号:2024-021),董事长丁国兴先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机将前述回购股份全部用于公司股权激励及/或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币2亿元(含),不超过人民币4亿元(含)。

2024年4月13日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励,回购价格不超过7元/股(含),回购资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-022)。

2024年4月20日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-029)。

后续,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(2)公司2024年限制性股票激励计划事项进展情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司于2024年4月13日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2024年4月15日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《芯联集成电路制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-023)及《芯联集成电路制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本次激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计763人,激励对象需满足公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求。公司层面业绩考核要求为:以公司2021-2023年营业收入均值为业绩基数,对每个归属期定比业绩基数的累计营业收入增长率进行考核,第一个归属期(2024年)累计营业收入增长率目标值为60%,第二个归属期(2024-2025年)累计营业收入增长率目标值为254%,第三个归属期(2024-2026年)累计营业收入增长率目标值为508%。

2024年4月25日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《芯联集成电路制造股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2024-030),对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:芯联集成电路制造股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,804,957,714.89	3,995,220,464.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,821,164.00	50,370,000.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	703,553,316.35	550,294,845.42
应收款项融资		
预付款项	193,289,878.62	145,743,117.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,660,576.08	21,912,970.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,924,885,386.80	1,983,769,298.46
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,458,738,914.94	290,339,202.48
流动资产合计	10,179,906,951.68	7,037,649,899.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	418,782,638.89	217,101,736.11
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,490,952.38	60,925,427.40
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,334,895.91	69,637,873.79
固定资产	20,546,297,916.42	20,997,136,847.33
在建工程	1,158,091,246.64	1,252,287,367.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,375,804.86	35,111,937.50
无形资产	937,791,277.21	978,141,114.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	61,364,738.52	56,857,700.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,229,223,653.56	815,516,542.01
非流动资产合计	24,767,753,124.39	24,532,716,545.82
资产总计	34,947,660,076.07	31,570,366,445.66
流动负债:		
短期借款	2,261,845,611.91	2,596,241,971.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	992,673.14
衍生金融负债		
应付票据	287,274,511.04	158,214,713.06
应付账款	2,705,170,399.78	2,762,871,594.56
预收款项		
合同负债	462,326,602.57	571,727,634.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	86,781,458.54	139,656,094.54
应交税费	158,244,648.68	34,871,869.46
其他应付款	15,733,330.88	24,545,722.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	454,155,902.10	453,680,107.51
其他流动负债	55,101,734.17	66,327,044.96
流动负债合计	6,486,634,199.67	6,809,129,425.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,923,668,814.92	6,718,717,801.43
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,225,816.53	16,430,872.42
长期应付款	1,497,576,966.69	1,512,591,888.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	856,750,585.06	665,117,481.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,290,222,183.20	8,912,858,044.59
负债合计	18,776,856,382.87	15,721,987,469.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,045,747,150.00	7,044,602,275.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,489,203,791.64	9,480,395,743.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,284,041,001.51	-4,041,923,308.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,250,909,940.13	12,483,074,709.70
少数股东权益	3,919,893,753.07	3,365,304,266.00
所有者权益(或股东权益)合计	16,170,803,693.20	15,848,378,975.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,947,660,076.07	31,570,366,445.66

公司负责人:赵奇　主管会计工作负责人:王韦　会计机构负责人:张毅

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:芯联集成电路制造股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,352,995,972.16	1,154,539,275.25
其中:营业收入	1,352,995,972.16	1,154,539,275.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,039,548,677.57	1,594,028,971.57
其中:营业成本	1,443,312,704.15	1,126,916,378.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,048,520.39	2,545,725.43
销售费用	8,182,802.60	7,423,056.91
管理费用	29,892,595.76	27,289,114.80
研发费用	470,149,903.00	344,876,451.72
财务费用	75,962,151.67	84,978,244.68
其中:利息费用	110,500,257.70	126,796,991.73
利息收入	30,427,791.44	15,475,012.86
加:其他收益	320,749,001.41	29,629,306.98
投资收益(损失以"-"号填列)	2,982,320.86	12,238,979.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,434,474.96	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,235,295.13	-3,085,271.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	301,945.83	-228,697.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-287,431,709.07	-219,444,467.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,679,416.04	39,501.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-651,395,267.29	-620,340,344.80
加:营业外收入	1,367,063.93	38,101.30
减:营业外支出	2.65	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-650,028,206.01	-620,302,243.50
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-650,028,206.01	-620,302,243.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-650,028,206.01	-620,302,243.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-242,117,693.08	-499,593,092.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-407,910,512.93	-120,709,150.53
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-650,028,206.01	-620,302,243.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-242,117,693.08	-499,593,092.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-407,910,512.93	-120,709,150.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:赵奇　主管会计工作负责人:王韦　会计机构负责人:张毅

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:芯联集成电路制造股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,280,918,522.10	1,434,645,051.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	641,999.34	115,366,924.17
收到其他与经营活动有关的现金	358,657,950.28	120,447,126.82
经营活动现金流入小计	1,640,218,471.72	1,670,459,102.49
购买商品、接受劳务支付的现金	472,240,508.47	1,022,455,591.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	365,280,194.25	347,094,265.62
支付的各项税费	450,846,642.73	57,257,017.93
支付其他与经营活动有关的现金	45,733,859.99	26,058,621.70
经营活动现金流出小计	1,334,101,205.44	1,452,865,496.43
经营活动产生的现金流量净额	306,117,266.28	217,593,606.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	562,500.00	11,652,951.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	1,689,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,562,500.00	1,700,652,951.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,405,569,358.57	2,784,205,054.92
投资支付的现金	208,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	750,000,000.00	1,400,068,499.00
投资活动现金流出小计	2,363,569,358.57	4,184,273,553.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,213,006,858.57	-2,483,620,602.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	965,682,752.50	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,332,476,529.53	2,837,356,948.39
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,298,159,282.03	4,337,356,948.39
偿还债务支付的现金	1,408,599,103.59	1,888,320,466.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,840,833.44	108,688,003.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,228,431.59	
筹资活动现金流出小计	1,520,668,368.62	1,997,008,470.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,777,490,913.41	2,340,348,478.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,171,710.00	-8,942,550.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,859,429,611.12	65,378,931.05
加:期初现金及现金等价物余额	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
六、期末现金及现金等价物余额	5,764,657,714.89	1,685,750,132.61

公司负责人:赵奇　主管会计工作负责人:王韦　会计机构负责人:张毅

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688469　证券简称:芯联集成　公告编号:2024-032

芯联集成电路制造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,484,466,628
普通股股东所持有表决权数量	4,484,466,628
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.6478
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.6478

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事5人,现场结合通讯方式出席5人;

3、董事会秘书王韦先生现场出席了会议,其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,284,003	99.9736	1,182,625	0.0264	0	0.0000

2、议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,257,636	99.9730	1,182,625	0.0263	26,367	0.0007

3、议案名称:关于2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,257,636	99.9730	1,182,625	0.0263	26,367	0.0007

4、议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,257,636	99.9730	1,182,625	0.0263	26,367	0.0007

5、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,257,636	99.9730	1,182,625	0.0263	26,367	0.0007

6、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,257,136	99.9730	1,183,125	0.0263	26,367	0.0007

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,260,875	99.9731	1,179,386	0.0262	26,367	0.0007

8、议案名称:关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,260,375	99.9731	1,179,886	0.0263	26,367	0.0006

9、议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,260,375	99.9731	1,179,886	0.0263	26,367	0.0006

10、议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,260,375	99.9731	1,179,886	0.0263	26,367	0.0006

11、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,483,260,875	99.9731	1,179,386	0.0262	26,367	0.0007

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2023年度利润分配预案的议案	2,337,657,136	99.9482	1,183,125	0.0505	26,367	0.0013
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,337,660,875	99.9484	1,179,386	0.0504	26,367	0.0012
9	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,337,660,375	99.9484	1,179,886	0.0504	26,367	0.0012
10	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,337,660,375	99.9484	1,179,886	0.0504	26,367	0.0012
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,337,660,875	99.9484	1,179,386	0.0504	26,367	0.0012

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1-8为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次审议的议案9-11为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、本次审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:宋怡、陈乐淙

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688469　证券简称:芯联集成　公告编号:2024-033

芯联集成电路制造股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解质押及质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成"或"公司")股东绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"日芯锐")持有公司股份216,000,000股,绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"硅芯锐")持有公司股份230,400,000股,日芯锐及硅芯锐(以下合称"员工持股平台")为一致行动人,合并计算后持有公司446,400,000股,占公司总股本的6.34%。日芯锐前次累计质押股份160,000,000股,占员工持股平台所持有公司股份总数的35.84%,占公司目前总股本的2.27%。

● 日芯锐本次解质押股份80,000,000股,质押股份90,000,000股,本次解质押及质押后日芯锐累计质押股份数170,000,000股,占员工持股平台所持有公司股份总数的38.08%,占公司目前总股本的2.41%。

一、本次股份解质押及质押基本情况

公司近日接到股东日芯锐通知,获悉其所持有公司的部分股份解质押及质押。具体情况如下:

1、本次部分股份解质押的基本情况

股东名称	本次解除质押股份(股)	解除质押时间	质权人	占其所持股份比例	占员工持股平台所持股份比例	占公司总股本比例
日芯锐	80,000,000	2024年4月25日	招商银行股份有限公司绍兴分行	37.04%	17.92%	1.14%

2、本次部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占员工持股平台所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
日芯锐	否	90,000,000	是	否	2024年4月25日	至质权人申请解除质押为止	交银国际信托有限公司	41.67%	20.16%	1.28%	归还存量债务及利息
合计	-	90,000,000	-	-	-	-	-	41.67%	20.16%	1.28%	-

3、本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保,且相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。

4、本次解质押及质押的原因

前期由于出资金额较大,员工部分入股资金来源于向招商银行绍兴分行申请的并购贷款,金额为1.8亿元。日芯锐根据招商银行的合规要求及招商银行绍兴分行对此的授信方案规定,在公司上市完成后,将其持有的8000万股公司股票进行质押作为并购贷款的增信措施。

本次质押是日芯锐以公司9000万股公司股票进行融资,用于归还招商银行并购贷款的存量债务与利息,同时前次质押给招商银行的8000万股公司股票解质押。

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,日芯锐及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
日芯锐	216,000,000	3.07%	160,000,000	170,000,000	78.70%	2.41%	170,000,000	0	46,000,000	0
硅芯锐	230,400,000	3.27%	0	0	0%	0%	0	0	230,400,000	0
合计	446,400,000	6.34%	160,000,000	170,000,000	38.08%	2.41%	170,000,000	0	276,400,000	0

注:以上所有表格中的比例以四舍五入的方式保留两位小数,数据尾差为数据四舍五入相加所致。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688469　证券简称:芯联集成　公告编号:2024-034

芯联集成电路制造股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年5月9日(星期四)15:00-16:30

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2024年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/1dZ8KNflbtC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月30日披露公司《2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况、发展战略等情况,公司定于2024年5月9日(星期四)15:00-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办芯联集成电路制造股份有限公司2024年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2024年5月9日(星期四)15:00-16:30

2、会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)

3、会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员:

公司出席本次说明会的人员:

董事长:丁国兴先生

董事、总经理:赵奇先生

财务负责人、董事会秘书:王韦先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

投资者可于2024年5月9日(星期四)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1dZ8KNflbtC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月9日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张毅、商娴婷

联系电话:0575-88421800

联系邮箱:IR@unt-c.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688469　证券简称:芯联集成　公告编号:2024-035

芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月13日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,具体详见公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2023年10月15日至2024年4月14日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,共有2名核查对象存在公司股票交易记录,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。

经公司核查,2名核查对象在自查期间进行的股票交易完全系其根据公司公开信息和对二级市场的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息,不存在利用本次激励计划内幕信息买卖公司股票的情形。

除上述人员外,核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买卖公司股票的行为。

三、结论

综上,公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,并采取了充分必要的保密措施,在本次激励计划首次公开披露前6个月内,相关内幕信息知情人不存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688469　证券简称:芯联集成　公告编号:2024-031

芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期12个月);股票认购方式为网下,上市股数为812,160,000股。芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"芯联集成"、"公司")确认,上市流通数量等于该限售期内除保荐人海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"、"保荐人")跟投相关子公司海通创新证券投资有限公司外全部战略配售股份数量。

● 除上述首发战略配售股份外,本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,484,000,000股。

● 本次股票上市流通总数为3,296,160,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年5月10日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]548号),并经上海证券交易所同意,绍兴中芯集成电路制造股份有限公司(以下简称"本公司"或"中芯集成")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)169,200万股(行使超额配售选择权之前),并于2023年5月10日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为507,600万股,首次公开发行A股后总股本为676,800万股(行使超额配售选择权之前)。公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权已于2023年6月8日全额行使,对应新增发行股数25,380万股,由此公司总股本增加至702,180万股,其中有限售条件流通股5,981,223,727股,占本公司发行后总股本的85.18%,无限售条件流通股1,040,576,273股,占本公司发行后总股本的14.82%。

2023年11月10日,公司首次公开发行网下配售的59,223,727股限售股上市流通。具体详见公司于2023年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》(公告编号2023-035)。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股份,其中战略配售股东33名,对应限售股份数量812,160,000股,占公司股本总数的11.52%;首发限售股东26名,对应限售股份数量2,484,000,000股,占公司股本总数的35.26%。本次上市流通的限售股共涉及限售股东59名,限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股数量共计3,296,160,000股,占公司股本总数的46.78%,现限售期即将届满,该部分限售股将于2024年5月10日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年5月10日,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)169,200万股并在上海证券交易所科创板挂牌上市,本次发行完成后总股本为676,800万股,其中有限售条件流通股5,727,423,727股,无限售条件流通股1,040,576,273股。

2023年6月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》(公告编号:2023-017)。公司于2023年6月8日全额行使超额配售选择权,因行使超额配售选择权而延期交付的25,380万股股票,已于2023年6月13日登记于参与战略配售的投资者的股票账户名下,自本次发行的股票上市交易日(2023年5月10日)起锁定24个月或12个月。公司的股本总额由676,800万股变更为702,180万股。

2023年9月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-031)。公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为358人,行权股票数量为20,767,475股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2026年9月7日。行权后,公司的股本总额由7,021,800,000股变更为7,042,567,475股。

2023年11月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2023-038)。公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为41人,行权股票数量为2,034,800股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2026年11月27日。行权后,公司的股本总额由7,042,567,475股变更为7,044,602,275股。

2024年2月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-010)。公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为29人,行权股票数量为1,144,875股,自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2027年2月5日。行权后,公司的股本总额由7,044,602,275股变更为7,045,747,150股。

除上述股本变化外,本次上市流通的限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的股份锁定和减持的有关承诺情况如下:

(一)本次上市流通的首发限售股股东承诺:

"1、在以下两个日期孰晚之日届满前:(1)自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月;(2)法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会指导意见规定的其他本单位持有发行人股票上市后的限售期,本单位不转让或委托他人管理本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本单位持有的上述股份。

2、本单位根据自身的资金需求情况减持股份时将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关上市公司股票减持的规定,审慎制定股票减持计划,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行减持,并履行相应的信息披露义务。

上述承诺为本单位真实意思表示,本单位自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,将依法承担相应责任。"

(二)本次上市流通的战略配售限售股股东承诺:

本次上市流通的战略配售限售股股东承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起12个月。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

海通证券经核查认为:公司上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整,保荐人对公司本次限售股份解限上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为3,296,160,000股,占目前公司总股本的比例为46.78%。

本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股份数量为812,160,000股,占公司股本总数的11.52%,限售期为公司首次公开发行股票上市之日起12个月。本公司确认,上述上市流通数量等于该限售期内除保荐人跟投相关子公司海通创新证券投资有限公司外全部战略配售股份数量。

除首次公开发行战略配售股份外,其余本次上市流通的首次公开发行限售股数量为2,484,000,000股,占公司股本总数的比例为35.25%,限售期为自公司股票上市之日起12个月。

(二)本次上市流通日期为2024年5月10日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	181,440,000	2.58	181,440,000	0
2	共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	153,000,000	2.17	153,000,000	0
3	共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	153,000,000	2.17	153,000,000	0
4	MASTERWELL(HK) LIMITED	144,000,000	2.04	144,000,000	0
5	青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业(有限合伙)	139,680,000	1.98	139,680,000	0
6	共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)	126,000,000	1.79	126,000,000	0
7	青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)	115,200,000	1.64	115,200,000	0
8	宁波芯拓股权投资合伙企业(有限合伙)	109,440,000	1.55	109,440,000	0
9	青岛聚源银芯股权投资合伙企业(有限合伙)	108,000,000	1.53	108,000,000	0
10	宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	108,000,000	1.53	108,000,000	0
11	宁波芯宏股权投资合伙企业(有限合伙)	105,120,000	1.49	105,120,000	0
12	天津源峰磐茂股权投资中心(有限合伙)	95,040,000	1.35	95,040,000	0
13	青岛聚源芯越股权投资合伙企业(有限合伙)	85,680,000	1.22	85,680,000	0
14	厦门国贸海通鹭岛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
15	株洲市睿联国创创业投资合伙企业(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
16	广州辰途华芯创业投资基金合伙企业(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
17	青岛软芯创业投资合伙企业(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
18	苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
19	招银成长拾陆号(深圳)合伙企业(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
20	尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
21	盈富泰克(深圳)环球技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
22	青岛同创致创创业投资中心(有限合伙)	72,000,000	1.02	72,000,000	0
23	深圳市创新投资集团有限公司	72,000,000	1.02	72,000,000	0
24	宁波万芯股权投资合伙企业(有限合伙)	68,400,000	0.97	68,400,000	0
25	上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	54,000,000	0.77	54,000,000	0
26	苏州和基资本管理有限公司	18,000,000	0.26	18,000,000	0
27	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	103,409,673	1.47	103,409,673	0
28	富诚海富通芯锐1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	100,193,321	1.42	100,193,321	0
29	全国社保基金六零一组合	58,755,489	0.83	58,755,489	0
30	绍兴市科技创业投资有限公司	47,004,391	0.67	47,004,391	0
31	浙江富浙资本管理有限公司	47,004,391	0.67	47,004,391	0
32	基本养老保险基金一二零五组合	45,594,259	0.65	45,594,259	0
33	大家人寿保险股份有限公司	31,336,261	0.44	31,336,261	0
34	中国互联网投资基金(有限合伙)	31,336,261	0.44	31,336,261	0
35	中环领先半导体材料有限公司	31,336,261	0.44	31,336,261	0
36	富诚海富通芯锐3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	29,595,782	0.42	29,595,782	0
37	富诚海富通芯锐2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	28,383,128	0.40	28,383,128	0
38	全国社保基金一零九组合	26,165,778	0.37	26,165,778	0
39	全国社保基金五零二组合	26,165,778	0.37	26,165,778	0
40	杭州立昂微电子股份有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
41	宁波江丰电子材料股份有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
42	浙江万盛股份有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
43	浙江晶盛机电股份有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
44	上海国鑫创业投资有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
45	宁波TCL股权投资有限公司	15,668,130	0.22	15,668,130	0
46	浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙)	15,668,130	0.22	15,668,130	0
47	北京华峰测控技术股份有限公司	9,400,878	0.13	9,400,878	0
48	无锡锡创绍芯股权投资合伙企业(有限合伙)	9,400,878	0.13	9,400,878	0
49	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
50	上海硅产业集团股份有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
51	无锡芯朋微电子股份有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
52	深圳创维科技咨询有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
53	山东省新动能基金管理有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
54	青岛半导体产业发展基金合伙企业(有限合伙)	7,834,065	0.11	7,834,065	0
55	绍兴市国鼎私募基金管理有限公司	7,834,065	0.11	7,834,065	0
56	济南乾行二号股权投资基金中心(有限合伙)	7,834,065	0.11	7,834,065	0
57	南昌新世纪创业投资有限责任公司	7,677,383	0.11	7,677,383	0
58	上海申和投资有限公司	3,917,032	0.06	3,917,032	0
59	扬州扬杰电子科技股份有限公司	3,133,626	0.04	3,133,626	0
合计		3,296,160,000	46.78	3,296,160,000	0

注:持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数,总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成;

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售限售股	812,160,000	12
2	首发限售股	2,484,000,000	12
合计		3,296,160,000	-

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年4月30日